

平成 25 年度 三洋半導体・群馬大学連携大学院
博士後期課程：次世代集積回路工学特論／博士前期課程：集積回路設計技術
6 月 6 日（14:20～15:50,16:00～17:30）総合研究棟 502 号室

イントロダクトリートーク

三洋半導体株式会社 LSI 事業部 開発企画部 大石橋 康雄

回路シミュレーションで使われている SPICE モデルについて講義します。まず回路シミュレーションの解析方法と SPICE モデルの重要性について、また SPICE モデルが実際にどの様に組み込まれているか、個々モデルについて詳細を講義します。具体的には基本となる p-n 接合ダイオードの SPICE2 モデル、Bipolar では Ebers-Moll, Gummel-Poon モデル、MOSFET では BSIM3 モデルについて説明します。

SPICE モデルを理解することにより効率的な回路シミュレーションができることを目的にしています。

以上